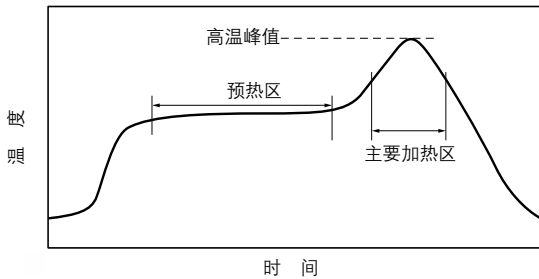


贴片电阻的推荐焊接条件

本产品推荐焊接条件及注意事项如下所示

● 短形焊盘图案设计例

- 最多使用2次回流焊。
- 超出正常温度时，请务必与本公司确认。
- 根据电路板及焊锡的种类，请事先确认产品端子部温度以及焊接特性。



共晶焊锡 (Sn/Pb 系列等)

	温度条件	时间
预热区	140 °C ~ 160 °C	60 秒 ~ 120 秒
主要加热区	200 °C 以上	30 秒 ~ 40 秒
高温峰值	235 ± 5 °C	10 秒以内

无铅焊锡 (Sn/Ag/Cu 系列等)

	温度条件	时间
预热区	150 °C ~ 180 °C	60 秒 ~ 120 秒
主要加热区	230 °C 以上	30 秒 ~ 40 秒
高温峰值	max. 260 °C	10 秒以内

● 浸流焊条件

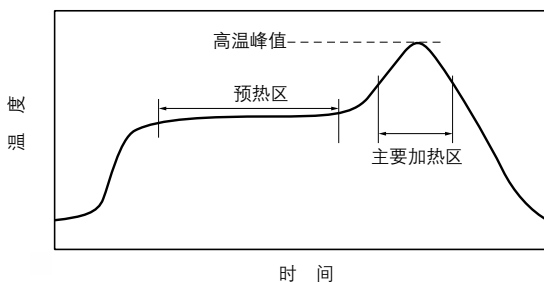
	共晶焊锡		无铅焊锡	
	温度条件	时间	温度条件	时间
预热区	140 °C ~ 160 °C	60 秒 ~ 120 秒	150 °C ~ 180 °C	60 秒 ~ 120 秒
焊锡	245 ± 5 °C	20 秒 ~ 30 秒	max. 260 °C	10 秒以内

多连贴片电阻路，耐硫化多连贴片电阻器，贴片电阻电路，贴片衰减器的推荐焊接条件

本产品推荐焊接条件及注意事项如下所示

● 短形焊盘图案设计例

- 最多使用2次回流焊。
- 超出正常温度时，请务必与本公司确认。
- 根据电路板及焊锡的种类，请事先确认产品端子部温度以及焊接特性。



共晶焊锡 (Sn/Pb 系列等)

	温度条件	时间
预热区	140 °C ~ 160 °C	60 秒 ~ 120 秒
主要加热区	200 °C 以上	30 秒 ~ 40 秒
高温峰值	235 ± 5 °C	10 秒以内

无铅焊锡 (Sn/Ag/Cu 系列等)

	温度条件	时间
预热区	150 °C ~ 180 °C	60 秒 ~ 120 秒
主要加热区	230 °C 以上	30 秒 ~ 40 秒
高温峰值	max. 260 °C	10 秒以内

● 浸流焊条件

由于端子间极易产生电桥串扰，因此请勿使用浸流焊。
关于 EXBA 型号的浸焊方式，敬请垂询。